
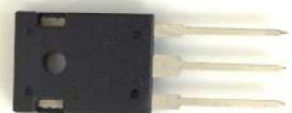
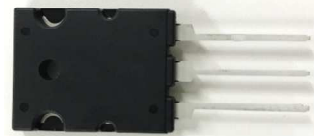
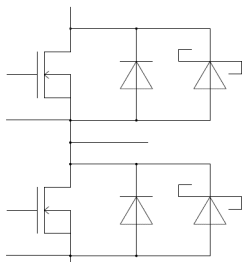
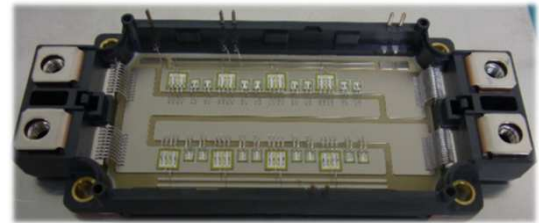
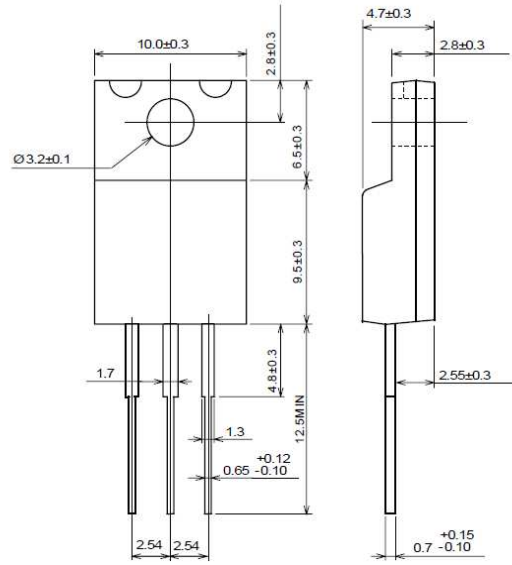


機種	絶縁方式	絶縁耐圧 (AC 1min)	Tj	Tstg	ダイパッド サイズ (x,y)mm	回路構成(例)	外観写真 ※搭載デバイスは組立実施例です。
		kVrms	℃	℃			
TO220F-3pin	樹脂絶縁	-	150	-40~150	4×7	ディスクリートタイプ	
TO247-3pin	非絶縁	-			11×7.5		
TO264-3pin	非絶縁	-			15×11		
ODT汎用モジュール I ODT自社開発パッケージ	セラミック基板	~8			トランジスタ部は MOSFET,IGBT搭載可	-	
ODT汎用モジュール II ODT自社開発パッケージ	絶縁シート	1 ※A					
ODT汎用モジュール III (廉価版)	絶縁シート	1 ※A					
ODT汎用モジュール IV (廉価版)	セラミック基板	~8					

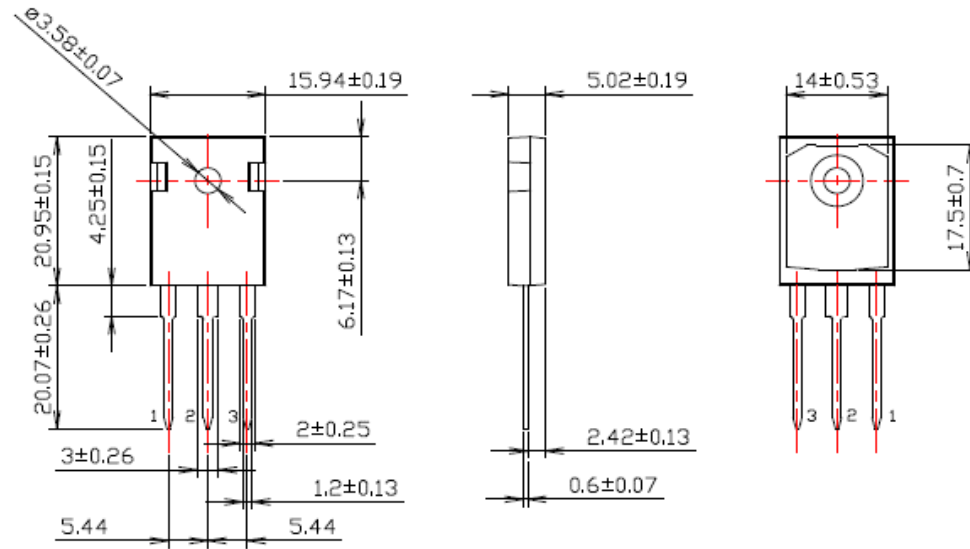
※A 弊社絶縁シート構造パワーモジュールの絶縁耐圧：AC1000kVrms 1分間 耐えること

■外形図

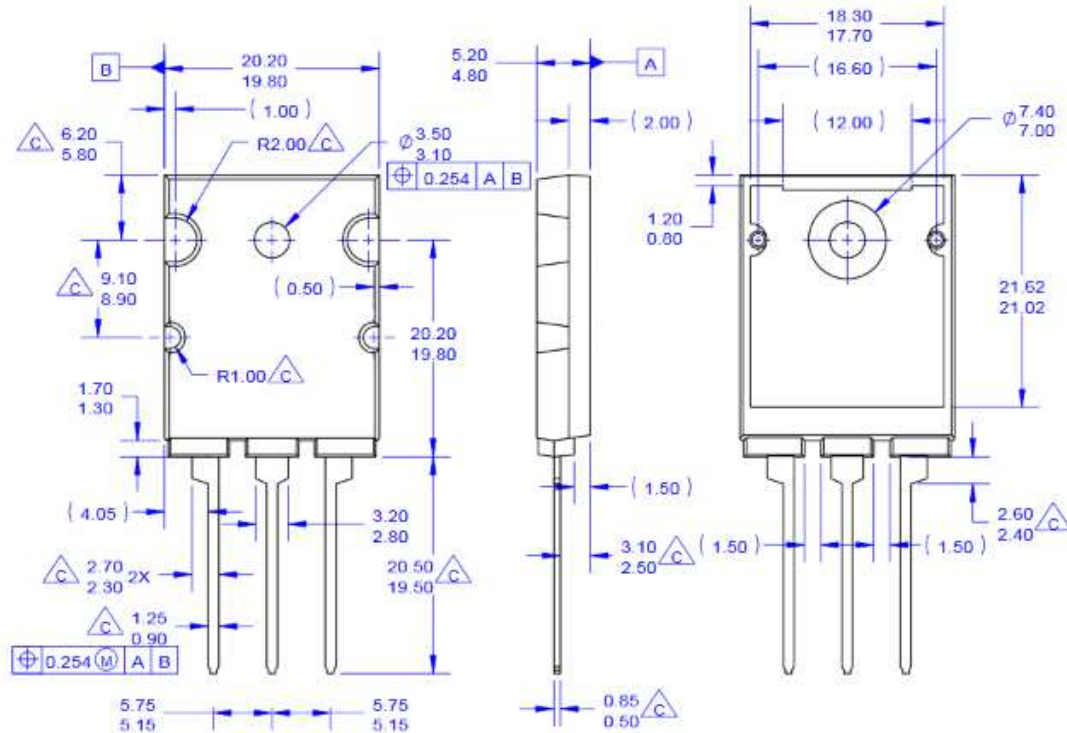
TO220F-3pin



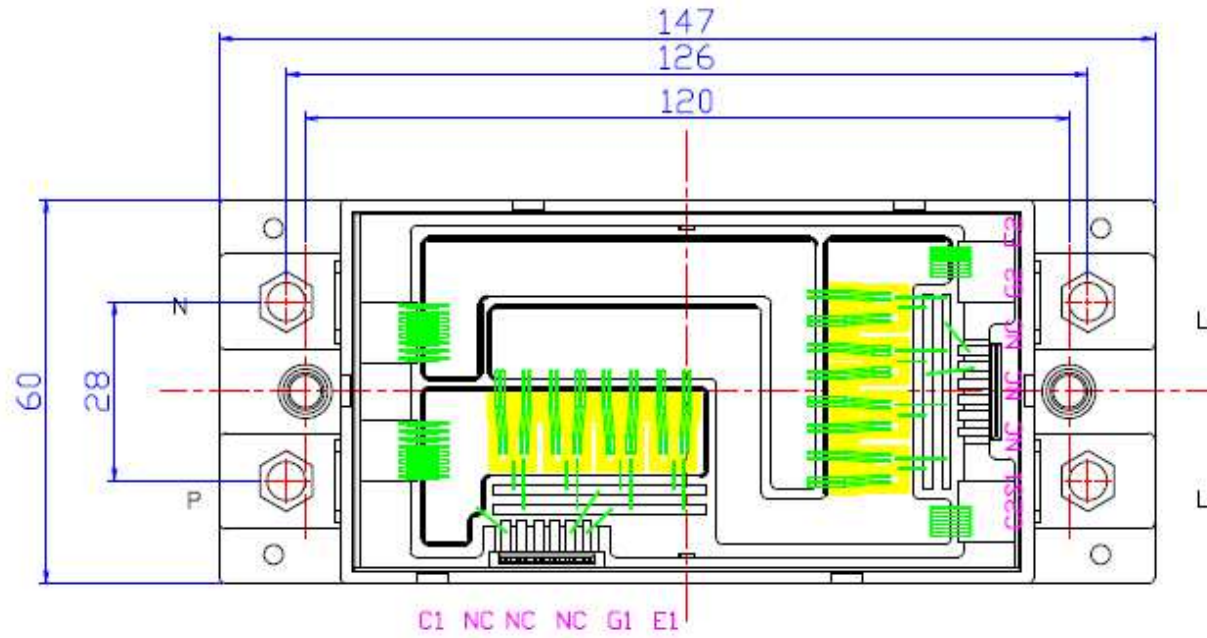
TO247-3pin



TO264-3pin



ODT汎用モジュール I II



ODT汎用モジュール III IV

